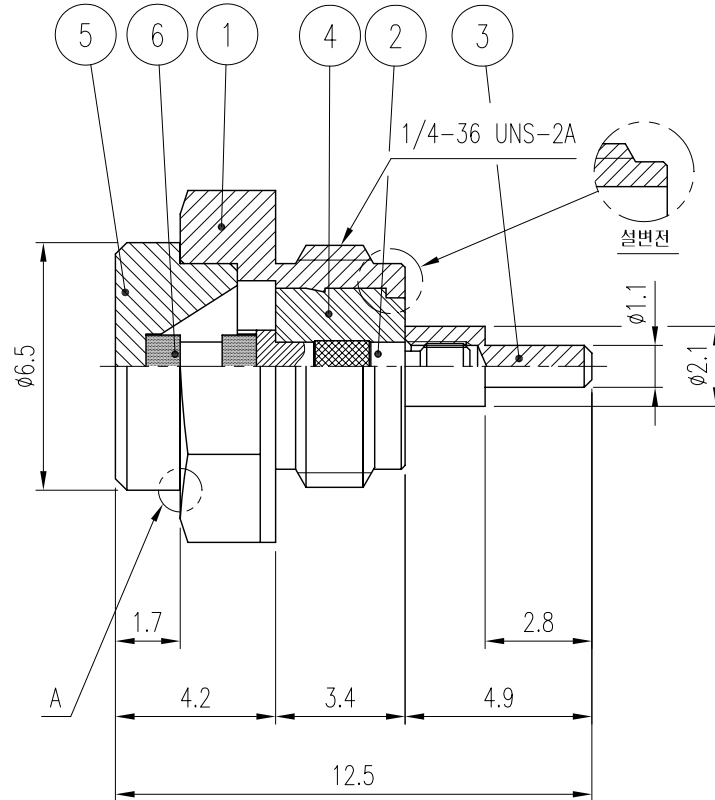
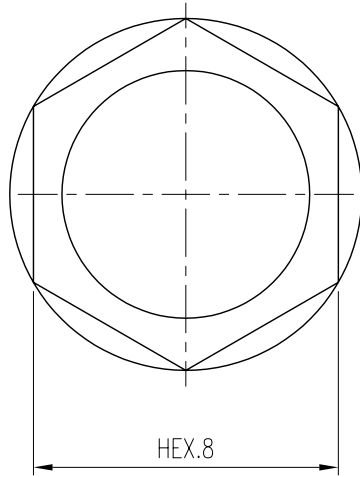


기재 ST							수 정 내 용			
							부호	내 용	수정자	승인자
ST(기준)							1	[설번NO. 연구2007-067] 산립성 향상		윤상진
ST(개선)							2	산립성향상[설번NO. 연구2007-134] (뒤지 배를 추가)	최유나	윤상진

A



조립주 기

1. 절연체에 PIN을 밀어 넣어 조립한다.
2. 조립된 절연체를 BODY에 끼운다.
3. 저항을 삽입한다.
4. COVER를 억지끼움한다. <표시 A부분 밀착 시킬 것.>
5. 4번까지 조립된 상태에 3번 PIN을 나사 체결 후 PIN 길이를 확인한다.
(LOC TITE를 바른다.)
6. 멀티미터기로 순수 저항 값을 측정할 것.
<저항값 48~52Ω>

6	RESISTOR	1			DRE00057-N/1 (XA118)
5	COVER	1	MBsBD	Gold Plate	DCO00068-5/1 (L2044)
4	INSULATOR	1	TEFLON		DIN01123-N/1 (H2359)
3	CONTACT(B)	1	MBsBD	Gold Plate	DCT01312-5/1 (E2554)
2	CONTACT(A)	1	MBsBD	Gold Plate	DCT01311-5/1 (E2553)
1	BODY	1	MBsBD	Gold Plate	DBD01687-5/1 (D2521)
품번	품 명	수량	재 질	표면처리	비 고

공통공차 .* ±0.1 .** ±0.05	년월일 2007. 3. 19.	 RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-32-347-8015 Fax : 82-32-347-8017			
재질	승인				
열처리	검도	도명 SMA-J-내장형TERM VER.2			
보호파막처리	제도				
	작성부서	연 구 소		A4	도번 TM00026-7/1 K314-953-004
	적도	5/1	단위 mm	중량	

B

B